证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2021-012

苏州昀冢电子科技股份有限公司关于投资汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资项目名称：汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目。

投资金额：项目总投资为 29,953.28 万元。

资金来源：自有资金以及自筹资金。

相关风险提示：

1、本次投资的项目需经公司股东大会审议通过后生效。投资项目是否能够实施尚存在不确定性，如因经营、市场需求、原材料价格波动等因素的影响，项目可能存在延期、变更或终止的风险。

2、项目投资资金来源部分为自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化，如影响项目实施进度，将不利于公司未来业务的持续发展。

3、拟投资项目实施后的财务费用、折旧摊销、现金流流出对公司的财务影响较大。如项目不能如期产生效益或实际收益低于预期，则可能会对公司财务状况产生一定不利影响。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

为满足在汽车电子和电子陶瓷领域不断增长的订单需求，苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司池州昀冢电子科技有限公司(以下简称“池州昀冢”)拟投资建设汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目，项目总投资为 29,953.28 万元，项目分三期投资，第一期计划投资为 16,823.97 万元，第二期计划投资为 7,377.41 万元，第三期计划投资为 5,751.90 万元。项目实施地点为安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区。实施本项目的资金来源主要为池州昀冢自有资金以及向银行申请授信额度。池州昀冢为本项目的实施主体，池州昀冢主营电子元器件的制造和销售，研发和制造汽车电子、陶瓷基板相关领域所需的精密电子零部件。

(二) 审批程序

公司于 2021 年 8 月 9 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于拟投资建设汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目的议案》，表决结果为：赞成票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。公司董事陆殷华对该议案投反对票，反对理由主要为：公司作为拟投资项目所属行业新进入者，在新产品的研发、客户拓展等方面将面临激烈的市场竞争，存在较大的市场风险；拟投资项目实施后的财务费用、折旧摊销、现金流流出以及项目产生的亏损对公司的财务影响较大；拟投资项目存在相应技术储备不完善、研发体系不可靠、相应的人才储备不足的风险。

董事会授权管理层相关人员负责本次投资项目的后续相关实施事宜，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司于 2021 年 8 月 9 日召开第一届监事会第十次会议审议通过《关于拟投资建设汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目的议案》，表决结果为：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、实施主体概况

(一) 实施主体基本信息

企业名称	池州昀冢电子科技有限公司
成立日期	2020 年 12 月 2 日
注册资本	15500 万元
经营范围	电子产品及配件、塑料制品、电子元器件、其他电子元件、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设备)、机电设备、五金机电、金属材料、模具的研发、生产、制造、销售；工艺品、生活日用品销售；电子产品技术咨询服务；从事自营货物及技术的进出口业务(国家限制和禁止出口的货物及技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
法定代表人	王宾
股权结构	公司 100%持股

(二) 池州昀冢的主要财务状况

项目	池州昀冢	
	2020/12/312020 年度	2021/03/31 2021 一季度
资产总额(元)	5,000,171.66	4,905,262.22
负债总额(元)	8.58	−883.84
资产净额(元)	5,000,163.08	4,904,541.46
营业收入(元)	0	0
净利润(元)	163.08	−93,853.94
扣除非经常性损益后的净利润(元)	163.08	−93,853.94

注：2020 年年度数据已经天衡会计师事务所审计，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日数据未经审计。

三、项目概况

(一) 合作背景

池州昀冢拟在安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区管委会的政策支持下，在安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区投资建设汽车电子精密零部件及陶瓷基板生产项目。目前，池州昀冢已从池州市自然资源和规划局取得宗地编号为 H15 地块的土地，宗地总面积为 100,534 平方米。

(二) 建设内容

1、本次项目中的汽车电子精密零部件，主要是指车身电子控制系统，其中主要包括防抱死制动控制(ABS)、驱动防滑(ASR)、电动动力转向、巡航系统、主动悬架控制、牵引力控制、电子稳定系统、胎压监测、灯光控制、电子仪表、自动空调、电动车窗、中控锁等模块。

2、本项目实施主体为池州昀冢电子科技有限公司，拟在安徽省池州市建设汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板生产基地，构建生产厂房及综合楼、食堂等配套设施，购置国内外先进的自动化生产设备，引进行业内人才，建设人才队伍，进一步扩充产能，满足公司在汽车电子和电子陶瓷领域不断增长的订单需求，提升公司市场地位。项目达产年公司将实现 300 万套汽车电子精密零部件和 200 万片电子陶瓷基板的产能目标。

项目总投资为 29,953.28 万元，建设期为 36 个月，共分三期建设实施，每年为一期。第一期计划投资 16,823.97 万元；第二期计划投资 7,377.41 万元；第三期计划投资 5,751.90 万元。

3、项目的工程建设周期计划分以下阶段实施完成，包括：可行性研究、初步规划与设计、建设工程及装修、设备采购及安装、人员招聘及培训、试运行。

4、本项目拟使用占地面积为 49,971.93 平方米的土地规划新建生产基地，用于建设三栋厂房、综合楼、食堂及安控、消防室、变电所、微型消防站等设施，新增建筑面积为 127,707.43 平方米；

5、购置注塑机、SMT 设备、激光打孔机、激光切割机、真空镀膜线、LDI 曝光机、平行光曝光机、旋切研磨机、三次元等国内外先进的生产设备，提升生产自动化能力。

四、对外投资的必要性和可行性分析

(一) 必要性分析

1、有利于公司扩充产品结构，增加新的利润增长点

公司在多年的经营中，专注于精密电子零部件产品制造技术开发和产品制造销售，严格把握生产质量，形成了规范的生产作业流程，凭借优异的产品设计与优良的产品质量，与下游客户达成长期稳定的合作。虽然公司的经营处于稳步发展中，但公司目前产品主要应用在消费电子领域，产品应用领域相对单一，存在市场抗风险能力不足等隐患。为此，公司需要丰富产品结构，进一步发挥在精密电子零部件制造领域的优势，抓住市场趋势，扩大业务范围。

在我国汽车电子产业与半导体行业发展良好的背景下，公司已将汽车电子精密零部件与电子陶瓷基板纳入战略发展规划，采用先进技术加大研发投入，为业务开辟单独产线与品质管控标准。公司目前生产场地已无法满足新的生产线置入，因此需要建立新的生产基地，扩大公司在汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板领域的生产能力，提高营业利润。

2、有利于把握陶瓷基板领域的发展机会，取得市场先发优势

随着各类产品向大功率化的方向快速发展，大功率产品消耗产生的大量热量对芯片基板的导热性、绝缘性等提出了更高要求。基板作为半导体产品的重要组成部分，直接影响着器件的性能、质量和可靠性。陶瓷基板的研发应用，有效解决了半导体行业中散热差、金属基板热电不分离的痛点，市场应用前景广阔。当前我国电子陶瓷基板在技术水平方面已经取得一定突破，与国际先进水平的差距不断缩小，但国内具有规模产能的生产企业较少，在产品质量一致性、批量生产方面的能力仍然不足，现有产量无法满足国内市场需求。

公司凭借前期的技术积累，在产品创新、自动化程度和工艺开发方面获得了较大进步。2020 年公司开始研发“高导热陶瓷电子线路基板”，主要采用 DPC 工艺(Direct Plated Copper 直接镀铜陶瓷基板)制备。为了抓住陶瓷基板领域快速发展带来的战略机遇，公司已将电子陶瓷基板作为重点拓展的方向。公司将从场地、设备、人员和管理等方面进行科学的规划布局，实现生产要素的最优组合，增强公司的综合竞争力，同时助力我国半导体产业良好健康发展。

3、有利于提高自动化水平，提高产品品质

精密电子零部件的加工涉及零件品种多变、批量小、形状复杂、精度高等问题，对设备和人员技能要求比较高。同时，客户对产品加工精度的要求正在逐步提升，使得产品对生产设备的稳定性、可靠性和精密性要求越来越高。自动化设备的应用可以降低对人员技能的要求，在提高产品生产效率的同时还能提高产品精度和稳定性，成为行业内企业的重点发展方向。

公司凭借前期的技术积累，在自动化程度方面取得了一定进步，自动化设备导入台数不断增高，单人工作效率不断提升，然而距离国际领先水平还有一定差距。在本项目的建设中，公司将引进行业内先进的自动化生产及检测设备，以满足下游市场对产品种类、性能、质量和交期等要求，提升生产制造水平，实现模块化生产和生产线全自动化生产和检测，进一步提高生产效率与产品品质。

(二) 可行性分析

1、技术储备

公司作为国内精密电子零部件行业中知名的高新技术企业，自成立以来始终高度重视产品技术的研发与积累。公司具备较强的研发实力，为公司布局汽车电子领域精密电子零部件的生产、制造和销售提供了良好的技术积累。目前公司已在精密电子零部件产品领域形成了丰富的技术储备，掌握了超精密加工技术、电镀技术工艺等行业领先的技术储备，有效强化了公司在技术方面的核心竞争力。

2、人才储备

精密电子零部件作为与汽车电子息息相关的行业之一，近年来随着“5G”、物联网等下游高新技术产业的持续稳定发展，其产品的质量与品质也在不断提升，行业市场竞争逐步加剧。为了面对竞争愈加激烈的市场状况，公司始终秉持“品质优良，技术专业，服务周到，永续经营”的经营理念，高度重视人才团队的培养，积累了大批与公司业务相匹配的人才储备。公司拥有一支行业经验丰富的专业团队，覆盖了采购、生产、研发、检测、品控、销售、服务等全流程各业务环节。

此外，根据业务发展需要，近年来公司打造了一套较为完善的绩效奖励与培养晋升体系，并持续引进精密电子零部件相关专业技术人才、高级管理人才等优质核心骨干，提高现有员工的素质，强化人力资源开发，导入竞争机制，推进人才内部交流，优化人才结构，最大化发挥人才优势，使人才队伍的综合素质和实力不断提升，为公司未来业务的持续拓展奠定可靠的人才基础，推动公司长期可持续发展。

3、生产运营管理体系

高品质的产品是公司核心竞争力之一，完善的生产管理体系提升了公司的口碑与知名度。经过多年的发展，目前已建立了较为成熟的生产运营管理体系，基本实现了自动化生产。公司自动化事业部已自主研制出多种自动化生产、检测设备，不仅改善了公司产品品质，提高产品生产效率，同时也为公司进军汽车电子、陶瓷基板等相关领域提供了可靠保障。

4、在质量管理体系方面，公司制定的《质量手册》，明确了所有产品的生产流程及质量标准，确保公司为客户提供零缺陷的产品和服务。未来随着本项目的投产，公司对生产工艺环节升级的需求会不断增多，产品质量管理难度也会不断增大，公司将继续执行全面的品质管控，汲取以往的设备研制、质量管理经验，为本项目的顺利实施提供经验支持。同时，随着公司在半导体引线框架领域产品能的增加，公司将继续招募行业内营销人才，完善市场营销团队，为产品产能消化提供基础保障。

五、对外投资对上市公司的影响

本次投资有助于完善公司的产业布局，有利于公司开拓新市场，增强公司在多领域发展的综合竞争力，同时会给公司带来新的利润增长点，降低公司对单一或少数行业的依赖，加强抗风险能力，符合公司长远发展规划和发展战略。

六、本次对外投资的风险

(一) 审批风险

本次投资的项目需经公司股东大会审议通过后生效，投资项目是否能够实施尚存在不确定性。

(二) 资金筹措风险

项目投资资金来源部分为自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化，如影响项目实施进度，将不利于公司未来业务的持续发展。

(三) 财务风险

本次对外投资将增加公司资本开支和现金支出。拟投资项目实施后的财务费用、折旧摊销、现金流流出对公司的财务影响较大。如项目不能如期产生效益或实际收益低于预期，则可能会对公司财务状况产生一定不利影响。

(四) 经营风险

本项目实施后，公司的生产管理范围将进一步扩大，组织结构和管理体系将不断扩充，公司在经营决策、资源整合、研发管理、人员管理等方面将面临更多的挑战，风险控制的难度大为增加。若公司现有的内部控制体系、技术人才的引进及培养、管理架构、管理人员素质、管理方式等无法适应公司规模的迅速扩张，各部门的工作无法对现有的规模做出相应的协调调整，将会产生管理上的风险，阻碍公司的经营和未来可持续发展。

(五) 市场风险

本项目拟生产产品汽车电子精密零部件主要应用于汽车电子产品中，近年来随着汽车辅助驾驶功能的不断完善和发展，汽车电子产业规模不断扩大，相应的汽车电子精密零部件市场也快速发展，但汽车行业受宏观经济万全全球经济环境变化影响较大，如未来公司汽车电子精密零部件下游市场出现重大不利影响而需求下降，将影响公司经营业绩。

本项目拟生产产品电子陶瓷基板应用市场广阔，被广泛应用于通讯、汽车、LED 照明、太阳能应用、消费电子等领域。近年来，随着中国经济迅速发展，国内消费结构升级，电子陶瓷基板行业快速发展，市场规模不断扩大。但如果未来下游应用市场需求规模及其发展趋势出现不利变化，将对本项目的实施造成一定程度的影响。

(六) 原材料价格波动风险

本项目中公司拟生产产品的主要原材料包括树脂、金属、贵金属、电子元器件、陶瓷等。其中金属、贵金属类属于大宗商品，其价格波动主要受宏观经济形势影响，电子元器件和陶瓷价格受下游行业周期和市场供需变化影响也较为明显。目前，公司已与主要原材料供应商建立了长期稳定的合作关系，但若市场供求变化、不可抗力等因素导致原材料采购价格发生大幅上涨，公司的盈利能力可能受到不利影响。

(七) 新增产能不能及时消化风险

本项目成功实施后，达产年公司将增加 300 万套汽车电子精密零部件和 200 万片电子陶瓷基板生产能力，有助于丰富公司产品结构，保持可持续发展。但相关产品产能的增加，将对公司的经营管理和销售能力提出更高的要求，如果新增产能产品未来下游应用市场竞争激烈或公司市场开拓能力受阻，则可能使公司面临新增产能不能及时消化的风险，从而对公司业绩产生不利影响。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 11 日

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2021-014

苏州昀冢电子科技股份有限公司关于投资半导体中高端引线框架生产项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资项目名称：半导体中高端引线框架生产项目。

投资金额：项目总投资为 10,150 万元。

资金来源：自有资金以及自筹资金。

相关风险提示：

1、本次投资的项目需经公司股东大会审议通过后生效。投资项目是否能够实施尚存在不确定性，如因经营、资金筹措和人才流失等方面因素的影响，项目可能存在延期、变更或终止的风险。

2、项目投资资金来源部分为自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化，如影响项目实施进度，将不利于公司未来业务的持续发展。

3、拟投资项目实施后的财务费用、折旧摊销、现金流流出对公司的财务影响较大。如项目不能如期产生效益或实际收益低于预期，则可能会对公司财务状况产生一定不利影响。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

为了增强苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的市场竞争力和后续发展，并推动公司在半导体引线框架市场的开拓，全资孙公司池州昀彩半导体材料有限公司（以下简称“池州昀彩”)拟投资半导体中高端引线框架生产项目，项目总投资为 10,150 万元，项目分两期投资，第一期计划投资为 5,020 万元，第二期计划投资为 5,130 万元。项目实施地点为安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区。实施项目的资金来源主要为池州昀彩自有资金以及向银行申请授信额度。池州昀彩为本项目的实施主体，池州昀彩主营电子元器件的制造和销售，研发和制造半导体引线框架相关领域所需的精密电子零部件。

(二) 审批程序

公司于 2021 年 8 月 9 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于投资半导体中高端引线框架生产项目的议案》，表决结果为：赞成票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。公司董事陆殷华对该议案投反对票，反对理由主要为：公司作为拟投资项目所属行业新进入者，在新产品的研发、客户拓展等方面将面临激烈的市场竞争，存在较大的市场风险；拟投资项目实施后的财务费用、折旧摊销、现金流流出以及项目产生的亏损对公司的财务影响较大；拟投资项目存在相应技术储备不完善、研发体系不可靠、相应的人才储备不足的风险。

董事会授权管理层相关人员负责本次投资项目的后续相关实施事宜，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司于 2021 年 8 月 9 日召开第一届监事会第十次会议审议通过《关于投资半导体中高端引线框架生产项目的议案》，表决结果为：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、实施主体概况

(一) 实施主体基本信息

企业名称	池州昀彩半导体材料有限公司
成立日期	2021 年 6 月 16 日
注册资本	100 万元
经营范围	一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；模具制造；模具销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；金属表面处理及热处理加工；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
法定代表人	甘子英
股权结构	公司 100%持股苏州昀彩精密冲压有限公司，苏州昀彩精密冲压有限公司 100%持股池州昀彩半导体材料有限公司

(二) 池州昀彩的主要财务状况

鉴于池州昀彩成立于 2021 年 6 月 16 日，截止目前，尚无可披露财务数据。

三、项目概况

(一) 建设内容

1、本项目实施主体为池州昀彩半导体材料有限公司，拟在安徽省池州市建设半导体中高端引线框架生产基地，基地由车间、原料仓库、成品仓库组成的主要生产系统，以及办公、供配电系统、环保设施、节能设施及消防设施等组成。本项目采用进口冲压机合作为主要生产设备，并采购与之配套的国内先进的辅助生产设备，以金属原材料为主要原料。坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，确保产品的质量，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化半导体引线框架生产基地，以满足当前市场的需求，进而增强企业的市场竞争力和后续发展，并推动公司在半导体引线框架市场的开拓。项目达产年公司将实现 100 亿个引线框架基地的产能目标。项目总投资为 10,150 万元，建设期限为 24 个月，前 12 个月为第一期建设，计划投资 5,020 万元，后 12 个月为第二期建设，计划投资 5,130 万元。

2、项目的工程建设周期计划分以下阶段实施完成，包括：可行性研究、初步规划与设计、建设装修、设备采购及安装、人员招聘及培训、试运行。

3、项目拟新建生产基地，规划建筑面积为 10,100 平方米，目前尚未取得相关土地。

4、购置冲压机、冲压周边设备、曝光机、镀银设备、压膜机、分片机、三次元等国内外先进设备。

四、必要性和可行性分析

(一)必要性

公司在多年的生产经营中，专注于精密电子零部件产品的开发和产品制造，严格把握生产质量，凭借优异的产品设计与优良的产品质量，与下游客户达成长期稳定的合作，但公司目前产品主要应用在消费电子领域，应用领域相对单一，对市场抗风险能力存在隐患。本次项目的投资将进一步加强公司在半导体领域的拓展，丰富产品结构，进一步发挥公司在精密电子零部件制造领域的竞争优势，扩大业务范围。

(二)可行性

1、本次投资项目是公司依据现有技术的基础上去扩大半导体领域的市场份额，同时公司培养了一批优秀的管理和技术团队，为整个投资项目的顺利实施提供了有力的人力保证。通过本次项目的实施，进行自主创新，大力增强公司在半导体集成电路引线框架产品方面的加工、设计、制作能力，进而提升公司的自主创新和开发能力，提高公司的整体竞争水平。

2、公司具备健全的治理结构，能够高质量与高效率的达成公司的工作指标。公司经过多年的发展已具备一定的项目计划、组织、协调、执行及控制能力，在项目管理团队的建设、项目计划的执行、项目成本的控制、项目质量的管理以及项目进度把控等方面都具备丰富的经验，为项目的顺利实施奠定了良好的基础。

3、经过多年的发展和实践，公司已建立了较为成熟的生产运营管理体系，基本实现了自动化生产。公司自动化事业部已自主研制出多种自动化生产、检测设备，不仅改善了公司产品品质，提高产品生产效率，同时也为公司进军半导体引线框架领域提供了可靠保障。

4、在质量管理体系方面，公司制定的《质量手册》，明确了所有产品的生产流程及质量标准，确保公司为客户提供零缺陷的产品和服务。未来随着本项目的投产，公司对生产工艺环节升级的需求会不断增多，产品质量管理难度也会不断增大，公司将继续执行全面的品质管控，汲取以往的设备研制、质量管理经验，为本项目的顺利实施提供经验支持。同时，随着公司在半导体引线框架领域产品产能的增加，公司将继续招募行业内营销人才，完善市场营销团队，为产品产能消化提供基础保障。

五、对外投资对上市公司的影响

本次投资有助于完善公司的产业布局，有利于公司开拓新市场，增强公司在多领域发展的综合竞争力，同时会给公司带来新的利润增长点，降低公司对单一或少数行业的依赖，加强抗风险能力，符合公司长远发展规划和发展战略。

六、本次对外投资的风险

(一) 审批风险

本次投资的项目需经公司股东大会审议通过后生效，投资项目是否能够实施尚存在不确定性。

(二) 资金筹措风险

项目投资资金来源部分为自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化，如影响项目实施进度，将不利于公司未来业务的持续发展。

(三) 财务风险

本次对外投资将增加公司资本开支和现金支出。拟投资项目实施后的财务费用、折旧摊销、现金流流出对公司的财务影响较大。如项目不能如期产生效益或实际收益低于预期，则可能会对公司财务状况产生一定不利影响。

(四) 经营风险

本项目实施后，公司的生产管理范围将进一步扩大，组织结构和管理体系将不断扩充，公司在经营决策、资源整合、研发管理、人员管理等方面将面临更多的挑战，风险控制的难度大为增加。若公司现有的内部控制体系、技术人才的引进及培养、管理架构、管理人员素质、管理方式等无法适应公司规模的迅速扩张，各部门的工作无法对现有的规模做出相应的协调调整，将会产生管理上的风险，阻碍公司的经营和未来可持续发展。

(五) 市场风险

本项目拟生产产品汽车电子精密零部件主要应用于汽车电子产品中，近年来随着汽车辅助驾驶功能的不断完善和发展，汽车电子产业规模不断扩大，相应的汽车电子精密零部件市场也快速发展，但汽车行业受宏观经济万全全球经济环境变化影响较大，如未来公司汽车电子精密零部件下游市场出现重大不利影响而需求下降，将影响公司经营业绩。

本项目拟生产产品电子陶瓷基板应用市场广阔，被广泛应用于通讯、汽车、LED 照明、太阳能应用、消费电子等领域。近年来，随着中国经济迅速发展，国内消费结构升级，电子陶瓷基板行业快速发展，市场规模不断扩大。但如果未来下游应用市场需求规模及其发展趋势出现不利变化，将对本项目的实施造成一定程度的影响。

(六) 原材料价格波动风险

本项目中公司拟生产产品的主要原材料包括树脂、金属、贵金属、电子元器件、陶瓷等。其中金属、贵金属类属于大宗商品，其价格波动主要受宏观经济形势影响，电子元器件和陶瓷价格受下游行业周期和市场供需变化影响也较为明显。目前，公司已与主要原材料供应商建立了长期稳定的合作关系，但若市场供求变化、不可抗力等因素导致原材料采购价格发生大幅上涨，公司的盈利能力可能受到不利影响。

(七) 新增产能不能及时消化风险

本项目成功实施后，达产年公司将增加 300 万套汽车电子精密零部件和 200 万片电子陶瓷基板生产能力，有助于丰富公司产品结构，保持可持续发展。但相关产品产能的增加，将对公司的经营管理和销售能力提出更高的要求，如果新增产能产品未来下游应用市场竞争激烈或公司市场开拓能力受阻，则可能使公司面临新增产能不能及时消化的风险，从而对公司业绩产生不利影响。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 11 日

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2021-015

苏州昀冢电子科技股份有限公司关于为下属企业申请授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：

1、苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司池州昀冢电子科技有限公司(以下简称“池州昀冢”)。

2、公司全资孙公司池州昀彩半导体材料有限公司(以下简称“池州昀彩”)。

担保金额：

1、公司拟为池州昀冢提供不超过 140,000 万元的连带责任担保。截至本公告日，不包含本次担保，公司已为池州昀冢提供的担保余额为 0 万元。

2、公司拟为池州昀彩提供不超过 8,500 万元的连带责任担保。截至本公告日，不包含本次担保，公司已为池州昀彩提供的担保余额为 0 万元。

本次担保未提供反担保。

本事项尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

1、担保基本情况

鉴于公司全资子公司池州昀冢拟投资建设汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目和片式多层陶瓷电容器项目、全资孙公司池州昀彩拟投资建设半导体中高端引线框架生产项目(详见公司于 2021 年 8 月 11 日刊登于指定信息披露媒体的《关于投资汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目的公告》《关于投资片式多层陶瓷电容器项目的公告》《关于投资半导体中高端引线框架生产项目的公告》，公告编号：2021-012、2021-013、2021-014)，池州昀冢拟申请不超过人民币 140,000 万元的银行授信额度，池州昀彩拟申请不超过人民币 8,500 万元的银行授信额度。在上述授信额度内，公司拟为池州昀冢和池州昀彩提供连带责任担保。

2、审议程序

公司于 2021 年 8 月 9 日召开的第一届董事会第十三次会议以 8 赞成、0 票弃权、1 票反对的表决结果审议通过了《关于为下属企业申请授信额度提供担保的议案》，本议案自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事陆殷华对该议案投反对票，反对理由主要为：公司作为拟投资项目所属行业新进入者，在新产品的研发、客户拓展等方面将面临激烈的市场竞争，存在较大的市场风险；拟投资项目实施后的财务费用、折旧摊销、现金流流出以及项目产生的亏损对公司的财务影响较大；拟投资项目存在相应技术储备不完善、研发体系不可靠、相应的人才储备不足的风险。

董事会授权董事长及其他管理层相关人员负责本次投资项目的后续相关实施事宜，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

企业名称	池州昀冢电子科技有限公司	池州昀彩半导体材料有限公司
统一社会信用代码	91341700MA2WG7JK0Q	91341700MA8LM5N27C
成立日期	2020 年 12 月 2 日	2021 年 6 月 16 日
注册资本	15500 万元	100 万元人民币
法定代表人	王宾	甘子英
注册地址	安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区乐山路以西汉江路以北地块	安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区皖江西路 7 号表面处理中心 4 号厂房
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	电子产品及配件、塑料制品、电子元器件、其他电子元件、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设备)、机电设备、五金机电、金属材料、模具的研发、生产、制造、销售；工艺品、生活日用品销售；电子产品技术咨询服务；从事自营货物及技术的进出口业务(国家限制和禁止出口的货物及技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；模具制造；模具销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；金属表面处理及热处理加工；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	苏州昀冢电子科技股份有限公司 100%持股	公司 100%持股苏州昀彩精密冲压有限公司，苏州昀彩精密冲压有限公司 100%持股池州昀彩半导体材料有限公司

此外，被担保人池州昀冢、池州昀彩均不是失信被执行人，也不存在影响其偿债能力的重大或有关事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项)。

2、财务信息

项目	池州昀冢		池州昀彩
	2020/12/312020 年度	2021/03/31 2021 一季度	
资产总额(元)	5,000,171.66	4,905,262.22	鉴于池州昀彩成立于 2021 年 6 月 16 日，截止目前，尚无可披露财务数据
负债总额(元)	8.58	−883.84	
资产净额(元)	5,000,163.08	4,904,541.46	
营业收入(元)	0	0	
净利润(元)	163.08	−93,853.94	
扣除非经常性损益后的净利润(元)	163.08	−93,853.94	

注：2020 年年度数据已经天衡会计师事务所审计，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司及池州昀冢、池州昀彩目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保额度(合计不超过人民币 14.85 亿元)仅为池州昀冢、池州昀彩拟申请的授信额度和公司拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

授权公司董事长签署担保合同等法律文件，具体担保事项以公司及池州昀冢、池州昀彩与拟合作银行根据实际情况签订的最终协议为准。

四、担保的原因和必要性

本次担保是为了满足全资子公司池州昀冢和全资孙公司池州昀彩的项目投资需要，有利于支持其良性发展，进而增强公司的整体竞争力，公司对池州昀冢和池州昀彩有充分的控制权，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

五、董事会、独立董事及监事会意见

公司董事会对本议案的表决结果为 8 票赞成、0 票弃权、1 票反对，公司董事陆殷华对本议案投反对票，反对理由见上文“一、担保情况概述”之“2.审议程序”。除陆殷华先生外的其他董事意见为：我们认为本次公司为全资子公司提供担保事项是在综合考虑子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。因此，同意公司为子公司提供担保事项，并将该议案提交股东大会审议。

独立董事认为：公司为全资子公司池州昀冢电子科技有限公司提供担保，是根据全资子公司业务经营需要及资金状况所进行的，有利于全资子公司筹措经营所需资金，促进其业务持续发展，进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。公司已就对外担保制定了完善的内部控制制度，能够规范对外担保行为，并控制对外担保风险。本次被担保方为公司全资子公司和全资孙公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，本次担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议本议案的程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《苏州昀冢电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的规定，因此一致同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

监事会后认为：公司为下属企业池州昀冢电子科技有限公司和池州昀彩半导体材料有限公司提供担保，是根据下属企业池州昀冢拟投资建设汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目和片式多层陶瓷电容器项目、池州昀彩拟投资建设半导体中高端引线框架生产项目的需要及资金状况所进行的，有利于下属企业筹措经营所需资金，促进其项目建设发展，进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。

公司已就对外担保制定了完善的内部控制制度，能够规范对外担保行为，并控制对外担保风险。本次被担保方为公司全资子公司和全资孙公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，本次担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议本议案的程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《苏州昀冢电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的规定，因此公司监事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的对外担保均为对控股子公司的担保，公司对控股子公司提供的担保总额为 318,643,312.40 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 133.97%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 51.94%(担保总额是指已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额之和，其中担保实际发生余额为 27,459,792.40 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.55%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 4.48%)。

截至本公告披露日，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 11 日

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2021-016

苏州昀冢电子科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司池州昀冢电子科技有限公司(以下简称“池州昀冢”或“债务人”)。

担保金额：公司拟为池州昀冢提供不超过人民币 60,000 万元的担保。截至本公告日，不包含本次担保，公司已为池州昀冢提供的担保余额为 0 万元，本次担保未提供反担保。

本事项尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

1、担保基本情况

池州昀冢为投资建设片式多层陶瓷电容器项目（详见公司于 2021 年 8 月 11 日刊登于指定信息披露媒体的《关于投资片式多层陶瓷电容器项目的公告》，公告编号：2021-013)拟委托苏美达国际技术贸易有限公司(以下称“苏美达”)代理进口设备。公司拟就池州昀冢委托苏美达代理进口设备事宜签署的包括但不限于《代理进口合同》在内的法律文件履行过程中所产生的应由债务人池州昀冢承担的全部债务，向苏美达提供不可撤销的